

**OMNIMATE Data - Jack RJ45
RJ45C5 S1D 2.7N4N RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



L'assortimento prodotti include i seguenti modelli:

- 90° orizzontale e 180° verticale
- con gancio verso l'alto / gancio verso il basso
- Processi di saldatura THT, THR o SMD
- Ampia gamma di forme diverse, anche con LED integrati e linguette per contatto schermato
- Categoria di prestazione da Cat. 3 a Cat. 6
- Versione con imballaggio in vassoio (TY) o su rotolo (Tape-on-Reel, RL)

Caratteristiche e vantaggi:

- Intervallo di temperatura ampliato da -40 °C a +85 °C per la massima capacità di prestazioni
- Lato dorato rinforzato (30µ") per una migliore protezione anticorrosione
- Il supporto di almeno 3 mm assicura una perfetta saldatura

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RJ45C5 S1D 2.7N4N RL
Nr.Cat.	2000890000
Versione	Connettore per circuito stampato, Jack RJ45, Cat. 5 , Collegamento a saldare SMD, 90°, Opzione Latch: basso, Linguette di schermatura: nessuno, 30-80 µ" Ni / 30- µ" Au , LED: No, Numero di poli: 8, Tape
GTIN (EAN)	4050118382440
CPZ	240 Pezzo
Imballaggio	Tape

**OMNIMATE Data - Jack RJ45
RJ45C5 S1D 2.7N4N RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	15,7 mm	Larghezza (pollici)	0,618 inch
Posizione verticale	14,85 mm	Altezza (pollici)	0,585 inch
Altezza minima	11,8 mm	Profondità	18,7 mm
Profondità (pollici)	0,736 inch	Peso netto	0,008 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	85 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura di magazzino, max.	85 °C	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	1,5 A	Resistenza contro l'isolamento	> 500 MΩ
Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V DC	Tensione nominale	125 V AC

Specifiche di sistema

Angolo di uscita	90°	Cablaggio	8 poli
Categoria	Cat. 5	Cicli di inserimento	750
Famiglia prodotti	OMNIMATE Data - Jack RJ45	Grado di protezione	IP20
LED	No	Linguette di schermatura	nessuno
Lunghezza spina a saldare (l)	3,2 mm	Materiale della schermatura	Lega di rame
Montaggio su circuito stampato	Collegamento a saldare SMD	Numero di codoli a saldare per polo	1
Numero di poli	8	Opzione Latch	basso
Passo in mm (P)	1,27 mm	Passo in pollici (P)	0,05 inch
Schermatura	Sì	Superficie di schermatura	nichelato
Tipo di collegamento	Femmina		

Dati del materiale

Materiale isolante	PA 9T	Colori	Nero
Tabella dei colori (simile)	RAL 9011	Gruppo materiali isolanti	II
CTI	≥ 500	Resistenza contro l'isolamento	> 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Materiale base dei contatti	Fosforo bronzo	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Struttura a strati del connettore maschio	30-80 μ" Ni / 30- μ" Au	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C
Temperatura di magazzino, max.	85 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	85 °C		

Imballaggio

Imballaggio	Tape	Lunghezza VPE	60 mm
Larghezza VPE	330 mm	Altezza VPE	330 mm
Diametro Ø bobina nastro (A)	330 mm	Resistenza superficiale	Rs = 10 ⁹ - 10 ¹² Ω

**OMNIMATE Data - Jack RJ45
RJ45C5 S1D 2.7N4N RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002637	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9.0	27-44-04-02	eClass 9.1	27-44-04-02

Approvazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

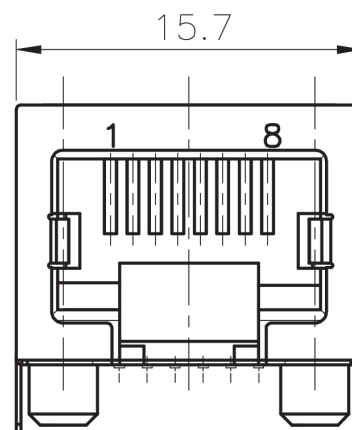
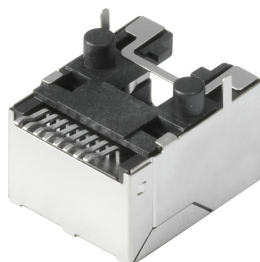
Brochure/Catalogo	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**OMNIMATE Data - Jack RJ45
RJ45C5 S1D 2.7N4N RL**

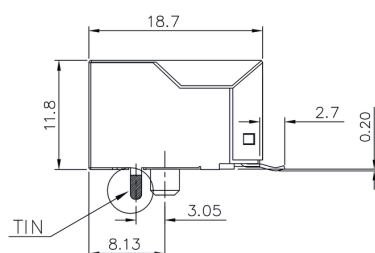
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

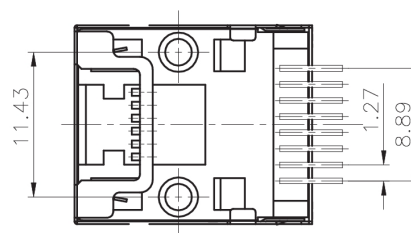
Disegno quotato



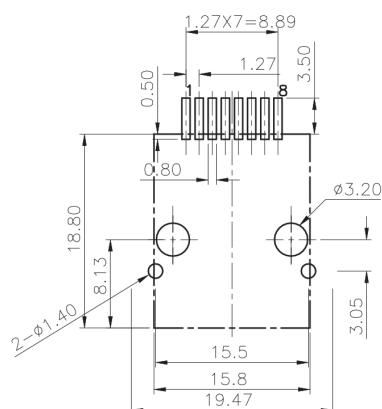
Disegno quotato



Disegno quotato



Disegno del circuito stampato

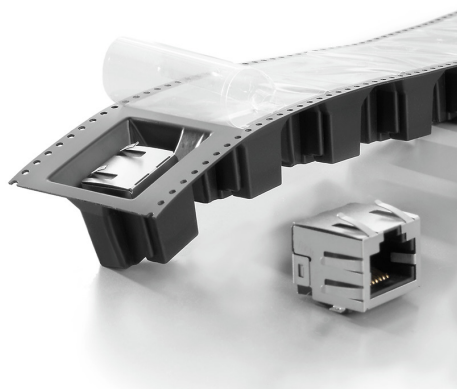


**OMNIMATE Data - Jack RJ45
RJ45C5 S1D 2.7N4N RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Vantaggi del prodotto



Process-optimised packaging
Tape-on-reel or tray

Vantaggi del prodotto

Vantaggi del prodotto



Trouble-free assembly
Short, chamfered solder pins



Suitable for all soldering processes
SMT, THT or THR

Data di creazione 12 giugno 2019 15.28.04 CEST

Versione catalogo 07.06.2019 / Con riserva di modifiche tecniche

**OMNIMATE Data - Jack RJ45
RJ45C5 S1D 2.7N4N RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Disegni**Legenda**

RJ45	G1	R	1	U	3.2	E	4	GY/GY	TY	RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.